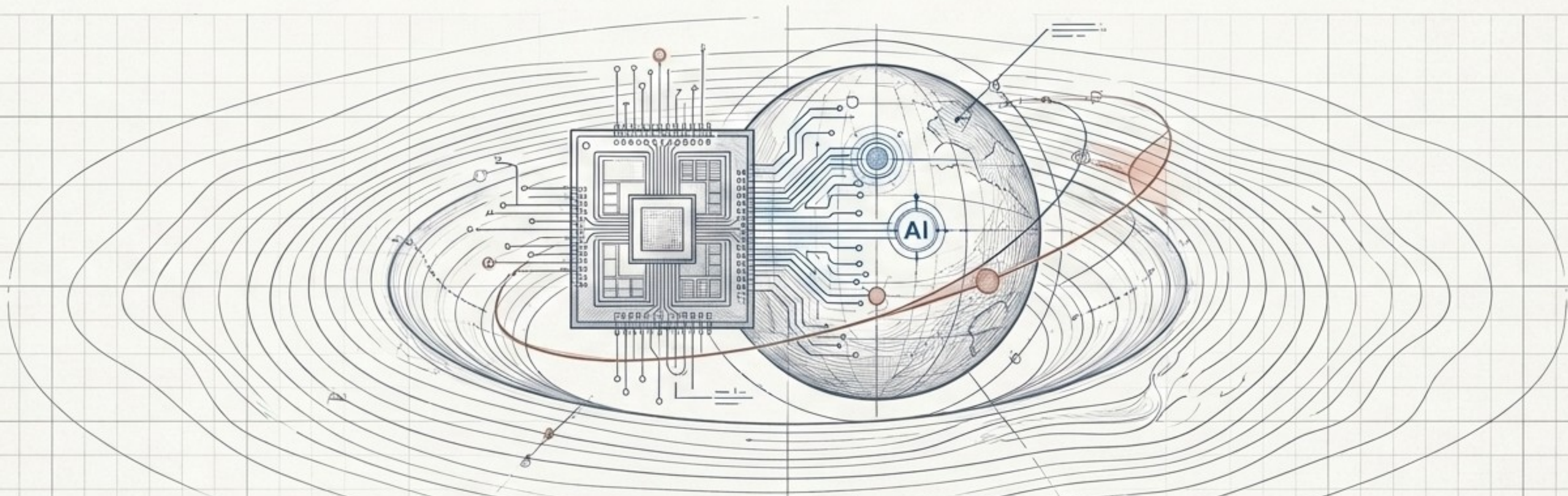


週間半導体ニュース 2026年5月15日～21日

2026年5月第3週 半導体市場インテリジェンス・ブリーフィング



機関投資家・サプライチェーン戦略家向けエグゼクティブ・サマリー

重要シグナル4点

1



\$298.5B

2026年Q1売上高・2030年1.5兆ドル軌道

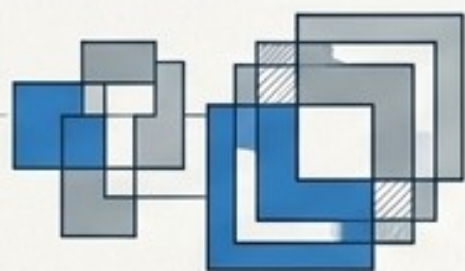
2



98% vs 18-Day

TSMCのCoWoS驚異的歩留まり vs 代替候補Samsungの労働ストライキ

3



\$1.5B / 300mm

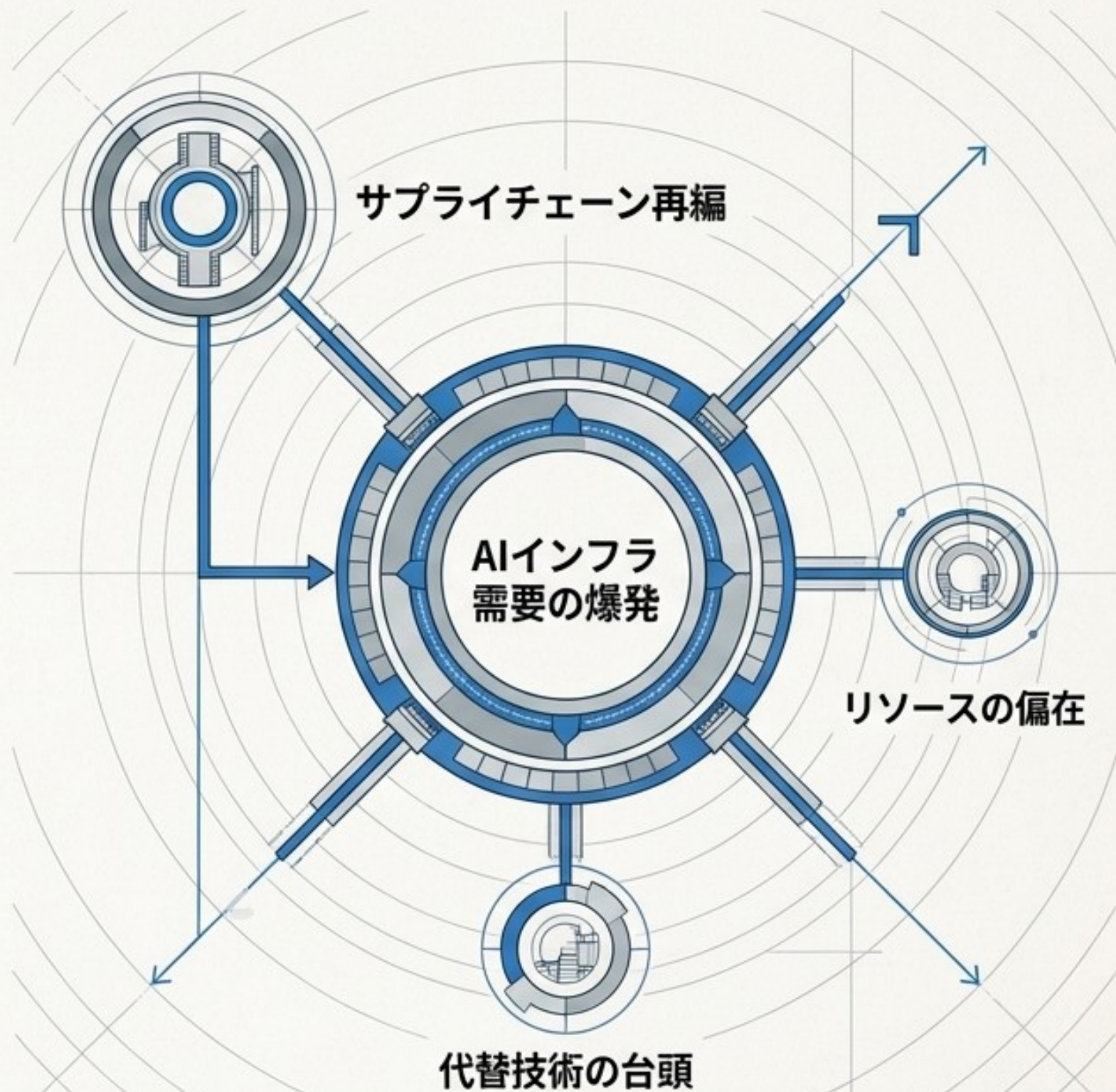
ADIのEmpower買収とTataのインド初300mmファブMoU

4



\$200M

CHIPS法から量子コンピューティングへの新規投資



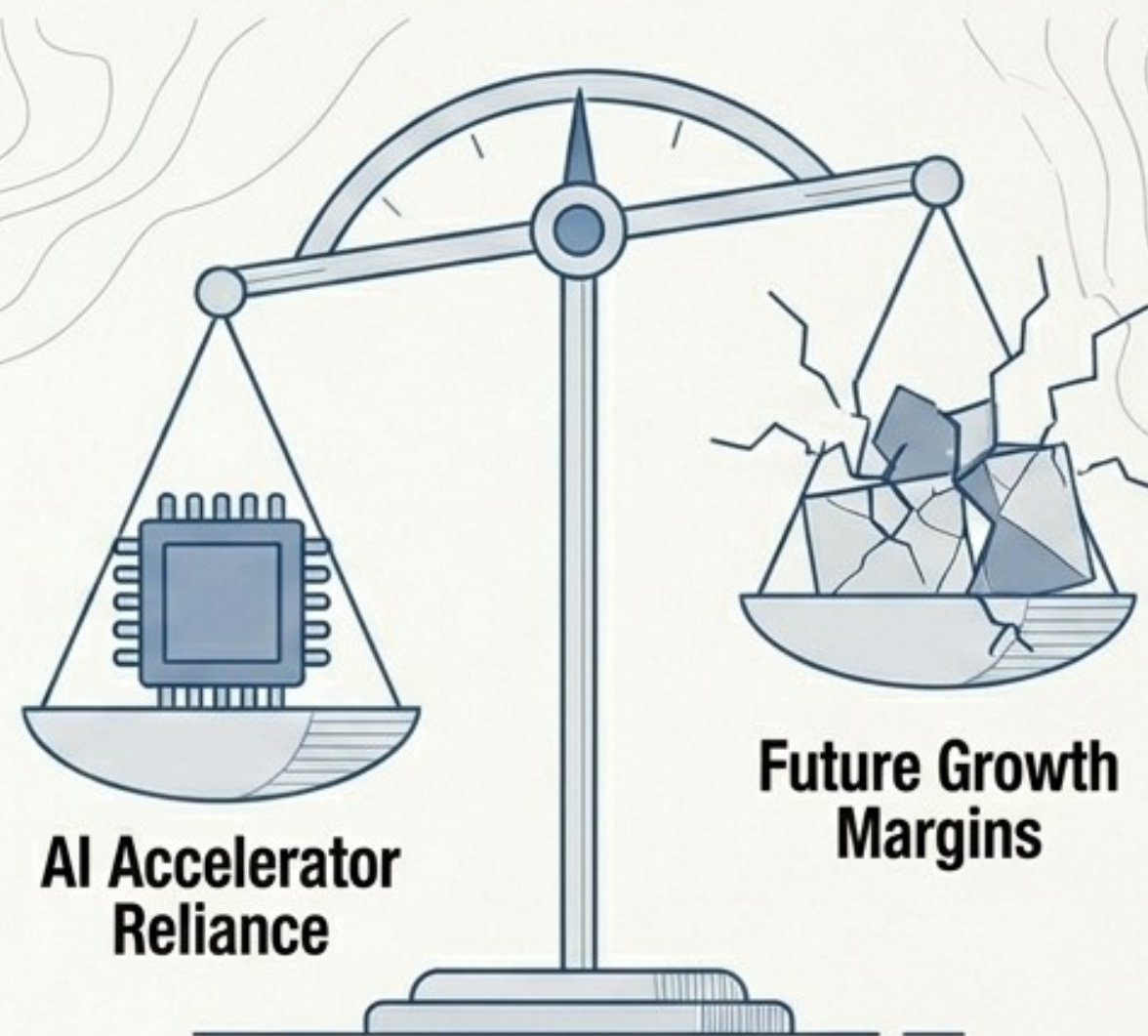
今週の全動向は単独の事象ではなく、「AIインフラ構築」という巨大な重力場に引き寄せられた連鎖反応である。

メガトレンド：\$1.5兆ドルへの軌道



2030年までにAI/HPCが業界全体の需要の55%を占める (TSMC予測)。

集中リスク (Systemic Vulnerability)



TechInsights警告：業界全体が単一のテクノロジーカテゴリーに過度に依存し、将来の成長マージンを賭けている現状。レガシープレイヤー（Hua Hong等）も特殊技術へ強制ピボット。



データセンター
\$75.2B (前年比+92%)



利益還元
+\$80B (自社株買い追加承認)、
\$0.25 (四半期配当・25倍増配)

\$81.6B



ネットワーキング
\$14.8B (前年比+199%の大幅増)

トップライン
前年比+85%, 前期比+20%



Q2見通し
\$91B (±2%)



戦略的注釈：対中ビジネスの完全凍結

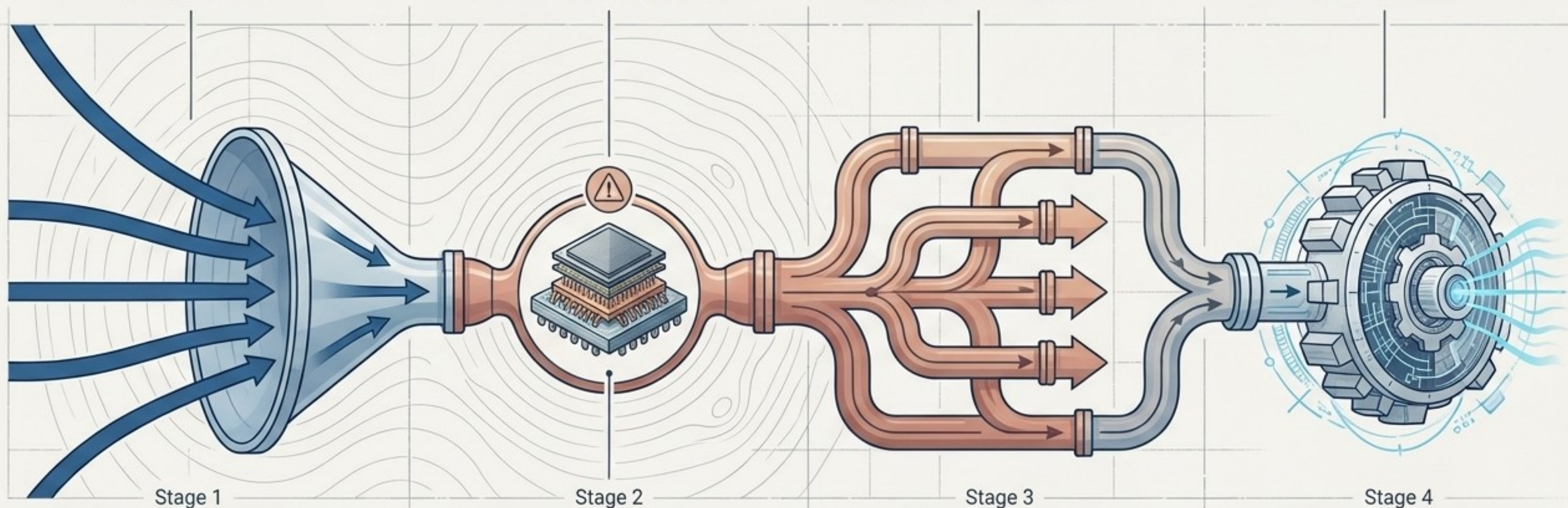
H200の限定ライセンス取得にもかかわらず、中国向けデータセンター売上は実質ゼロ。Q2見通しも中国向けをゼロと想定して組み立てられている点に注目。

Massive Influx (需要の津波)

The Bottleneck (TSMCの物理的限界)

The Overflow (迂回ルートの特集)

The Final Beneficiary (最終受益者)



Massive Influx (需要の津波)

AI/HPC Demand: AMD Lisa
Su急連訪台など供給確保の動き

The Bottleneck (TSMCの物理的限界)

CoWoS Advanced Packaging.
歩留まりは98%という驚異的水準。ア
リゾナ工場も黒字化。しかし「物理的
な生産能力」が完全に限界到達。

The Overflow (迂回ルートの特集)

Apple & Qualcommが一部用途で
IntelやSamsungファウンダリへの
分散を再評価。

The Final Beneficiary (最終受益者)

ASML: Apple-Intelの製造協議進行。
結果としてASMLに対し18~46億ユー
ロ規模の新規EUV発注が生まれる波及
効果。

グローバル・ファウンダリ・シフト (The Global Foundry Shift Table)

	TSMC	Samsung	Intel	Tata Electronics
Core Catalyst (需要要因)	AI需要の独占	Apple等の分散先候補	Qualcomm等の分散先候補	インド初の本格生産拠点
Strategic Focus (戦略的焦点)	CoWoSフル稼働・アリゾナ黒字化	先端チップの代替サプライヤー化	ファウンダリ事業の再建とシェア奪還	ASMLとの300mmファブに関するMoU締結 (\$11B投資)
Current Challenge (当面の課題)	物理的キャパシティの限界	18日間の労働ストライキによる供給不安	先端プロセスの歩留まり課題	グリーンフィールド(新規参入)の立ち上げリスク

オペレーション・リスク：Samsungのストライキがもたらす波紋

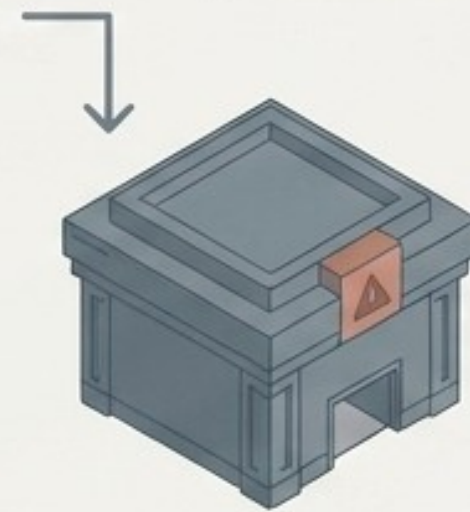
The Event

- 5月19日: ストライキ回避に向けた労使交渉が再開されるも決裂。
- 5月21日: 18日間にわたる労働ストライキが開始。

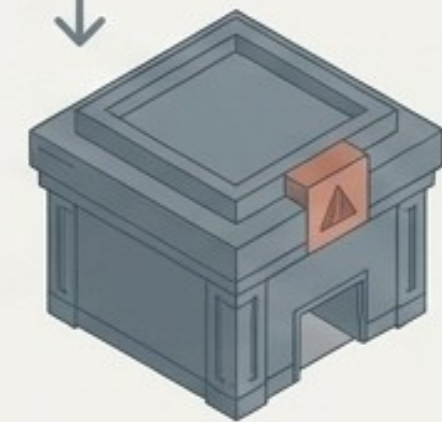
Market Implications



Step 1: 分散化戦略への冷や水
(TSMCの供給不足を補う最有力候補であるSamsungの生産不確実性が露呈)



Step 2: Apple & Qualcommの供給網
(代替サプライヤーとしての信頼性に短期的リスク)

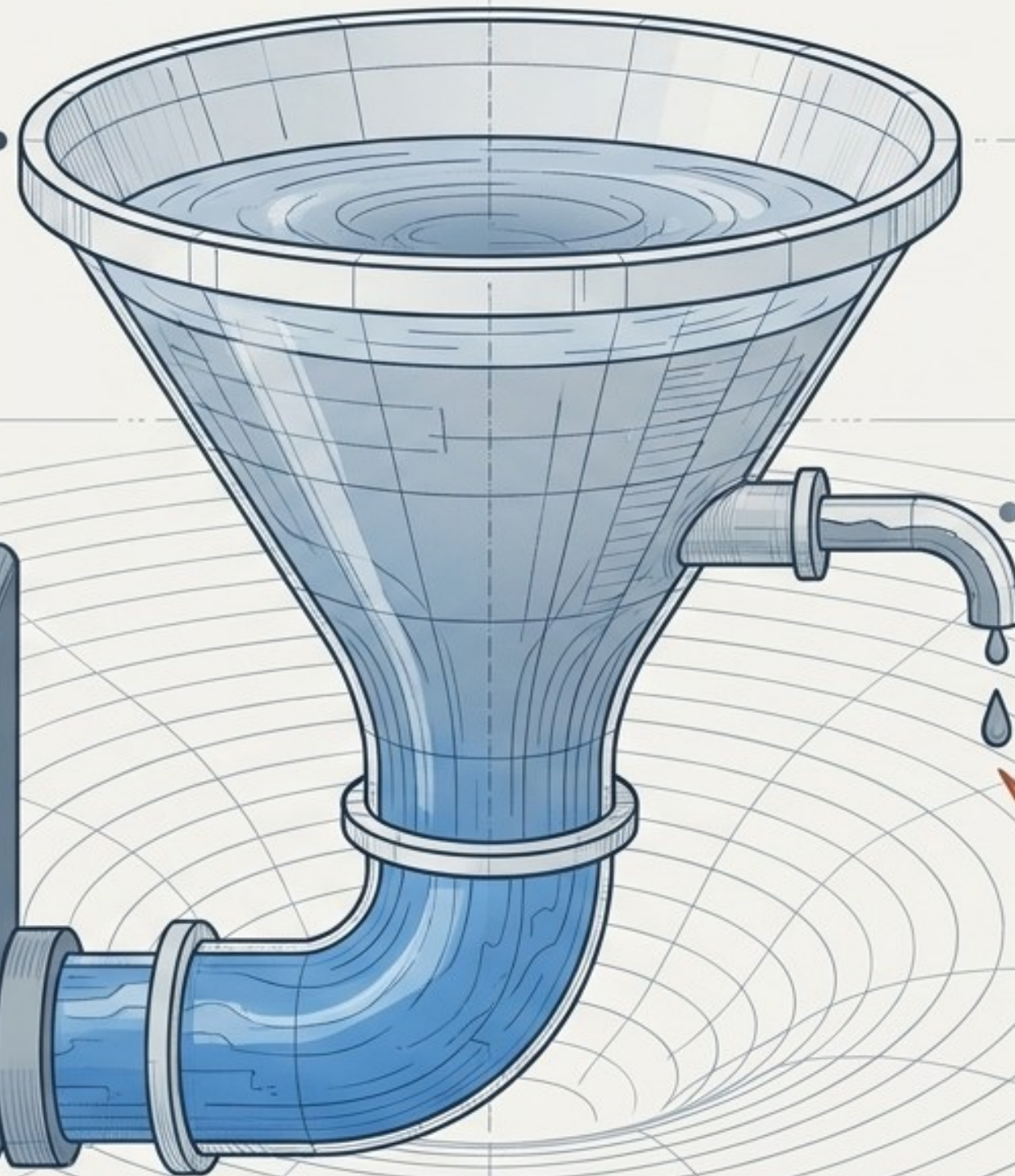


Step 3: 市場の反応
(供給懸念から半導体関連株の下落圧力が強まる)

Key Takeaway: Samsungのストライキは単なる労使問題ではなく、グローバルな「サプライチェーン分散化」に対する物理的ブレーキとして機能している。

The Resource Drain Funnel

吸い上げ元 (AI需要) :
巨大な引力を持つデータ
センターAIインフラ。



高利益HBM

Samsung, SK hynix, Micronが
生産ラインを高採算のAI向け
HBMへ急転換。ハイパー
ケーラーがSK hynixに増産資
金を直接提案する動きも。





汎用DRAM

車載向け・PC向けメモリ
の生産キャパシティが圧
迫され供給不足へ。

Timeline Alert:

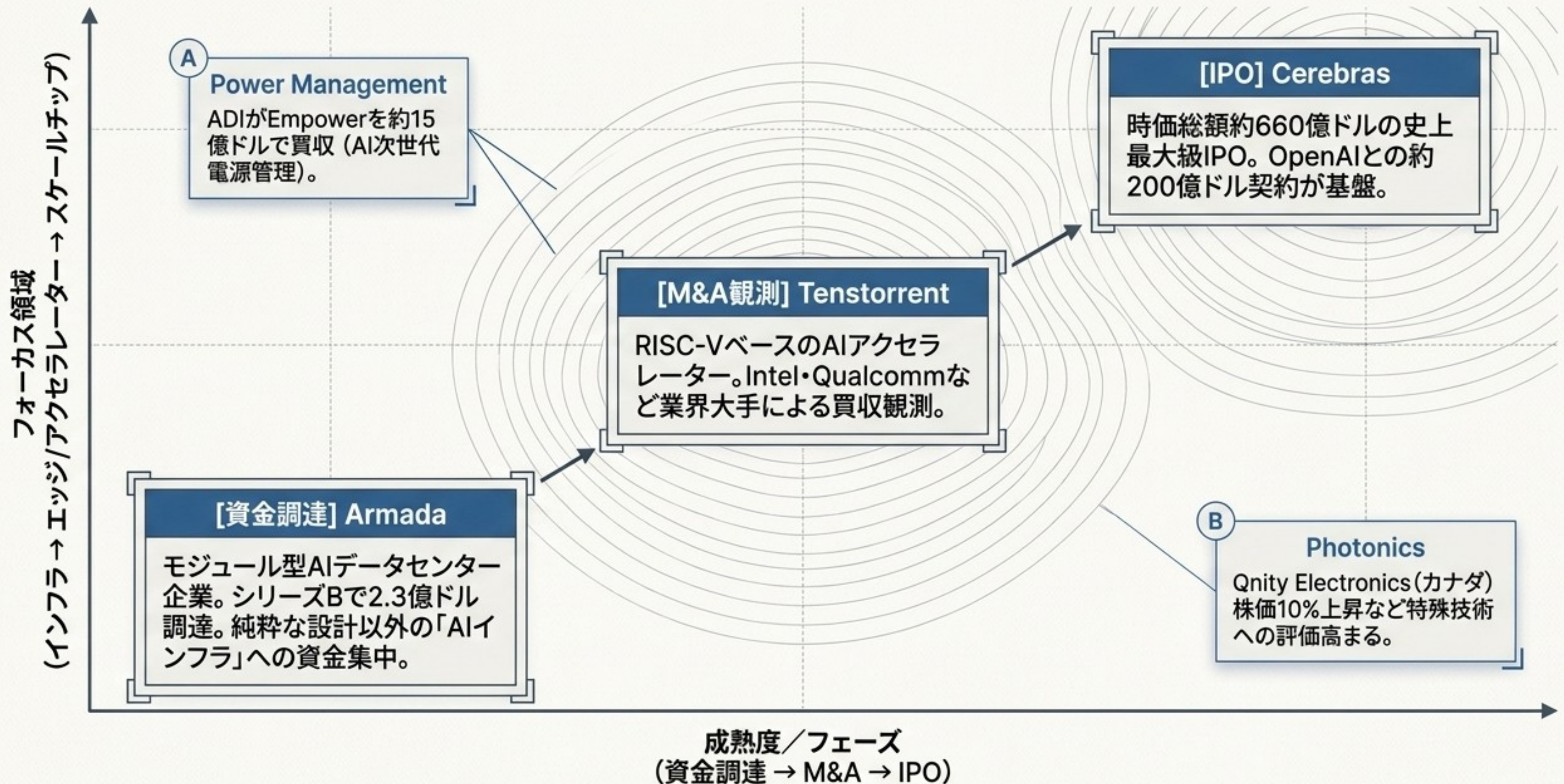
この構造的メモリ逼迫は、
少なくとも「2027年まで
継続見込み」。

The Silicon Hegemony Matrix

汎用GPU (General GPU)	カスタムASIC (Custom ASIC)
代表格: NVIDIA (Blackwell/Rubin)	代表格: Google TPU, AWS Trainium
現在の市場シェア:  約81% (圧倒的支配)	現在の市場シェア:  急成長中
2026年予測シェア:  シェア低下圧力	2026年予測シェア:  約27.8%へ拡大 (2023年以来の高水準)
コア戦略: 汎用性とソフトウェア(CUDA)エコシステムによる囲い込み	コア戦略: 自社インフラへの最適化によるコスト削減と特定タスクの高速化

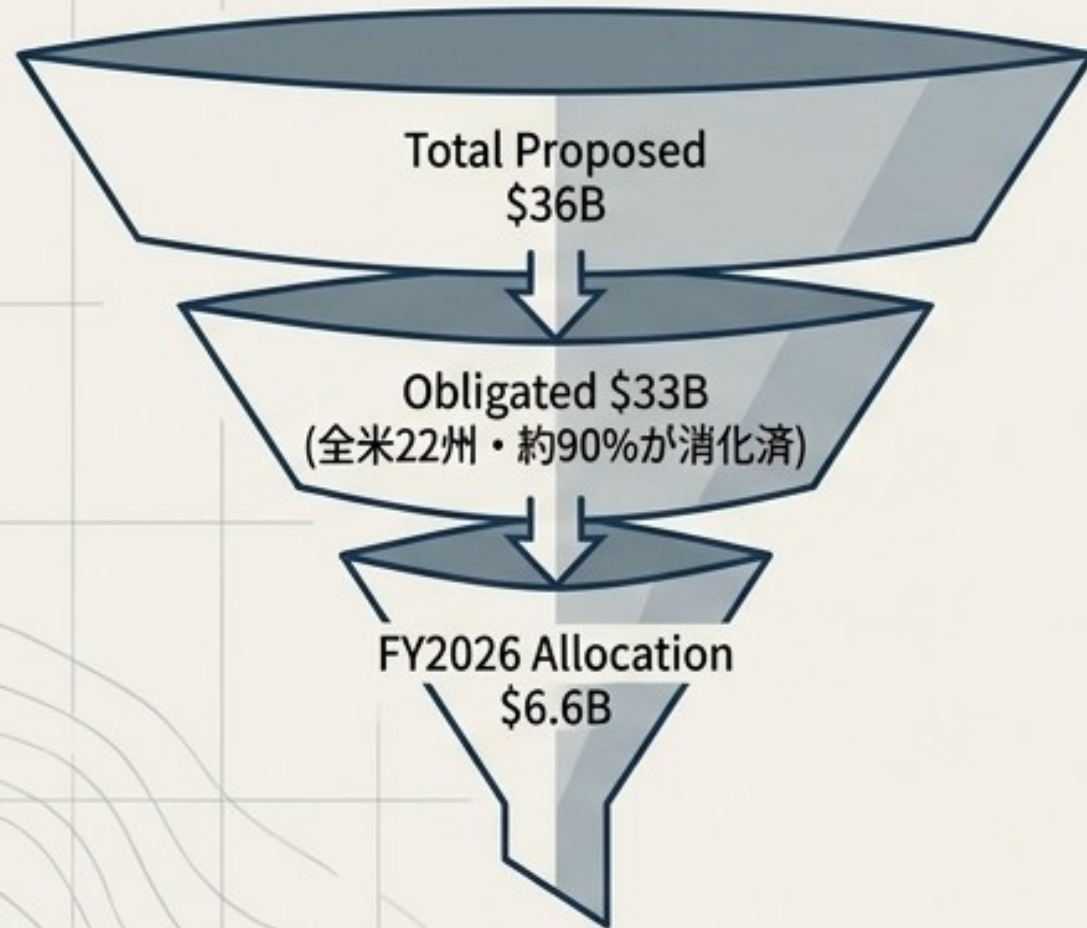
Insight: NVIDIAが市場を牽引する一方で、クラウド大手は自社製チップへの移行を加速させ、エコシステムの多極化が進行中。

The Ecosystem Maturity Axis



国内資金の枯渇と地政学的な「小休止」の対比

Funding Funnel: Domestic Funding Depletion



警告：重大なリスク：約6,400億ドルの米国投資の基盤「先端製造投資税額控除（第48D条）」が2026年末に失効予定。業界は延長を強くロビーイング中。

Geopolitical Balance: Global Policy Pause



米中関係の「小休止」：米中首脳会談（北京）。通商休戦を確認し、3年間の「戦略的安定」枠組みに合意。輸出規制の具体的強化は見送り。

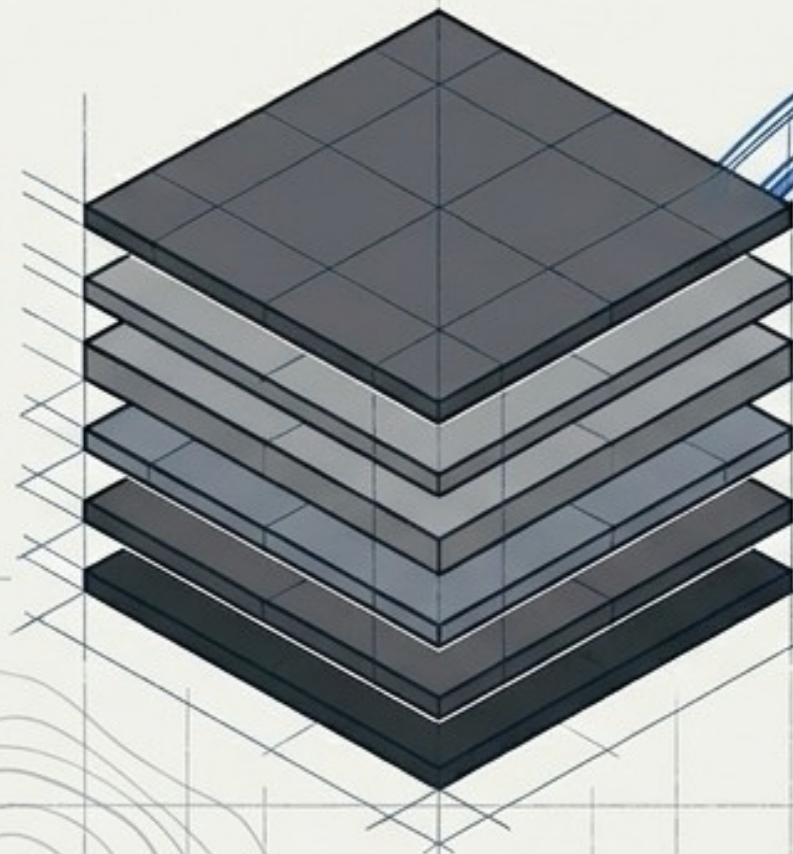
Insight: 激しい技術競争の裏で、政策面は次の一手への「踊り場（小休止）」を迎えている。

The Bridge Over the Silicon Chasm

シリコンの物理的限界:
伝統的なファブへの投資
枠が枯渇する中、政策
は非伝統的半導体へ舵
を切った。

CHIPS Act Capital: 4月20日
のCHIPS R&DオフィスのBAA改
定が布石となり、商業化段階の
技術への新しいパスが機能開始。

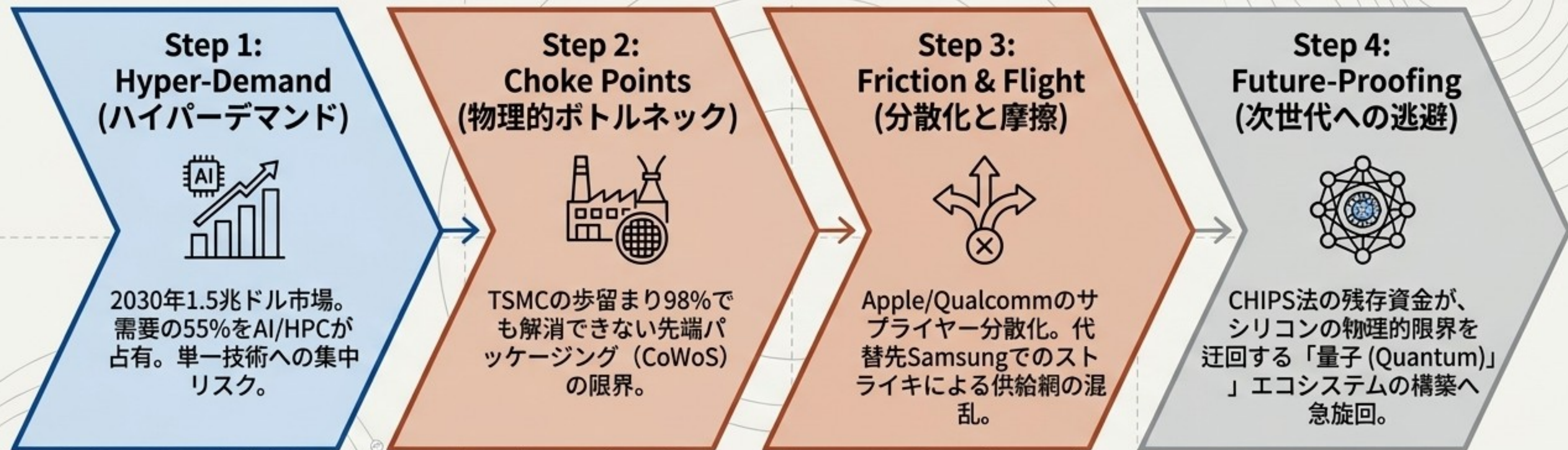
The Quantum LOIs - 5月20-21日



• **D-Wave (最大\$100M):**
大規模アニーリングお
よびゲートモデル量子
システムの加速。

• **Rigetti (最大\$100M/3年間):**
超伝導量子R&Dへの投資。

総括：AI駆動の波及効果 (The Ripple Effect Model)



Final Takeaway: 本週のあらゆる事象 (M&A、ストライキ、量子投資) は独立したニュースではない。すべては「AIの異常な需要の重力」が既存システムを破壊し、再構築している過程の現れである。

戦略的レーダー：今後の注目イベント



1 6月1日:
NVIDIA「N1X」発表

次世代アーキテクチャのロードマップ進捗。エコシステム全体の設計基準が再定義されるタイミング。



2 6月2日~5日:
Computex 2026開催
(台湾・台北)

各社AI PC、カスタムシリコンの最新動向発表の場。エッジAIへの重力の波及を確認する試金石。



3 Ongoing: 半導体税額控除 (25%) 延長の審議

第48D条の延長可否。2027年以降の米国ファブ設備投資計画 (Intel, TSMC Arizona) に直結する政策リスク。

The Silicon Dashboardは次なる構造変化を監視し続けます。